

半导体级石英锭

SEMICONDUCTOR GRADE QUARTZ INGOT

PQ811E
PQ811EH



应用领域 Application

作为反应室直接接触的各类石英装置的基础材料，应用于半导体晶圆制程工艺中。

Semiconductor grade quartz ingot is used as the base material of various quartz wares in direct contact with reaction chambers in semiconductor wafer manufacturing process.

产品特性 Characteristics

具备纯度高、低羟基、耐高温、微气泡少等特性。

Semiconductor grade quartz ingot features are high purity, low hydroxyl, good high-temperature resistance and few micro bubbles, etc.

产品规格 Product Size

单位 (Unit) : mm

产品类型
Code

尺寸范围
Size Range (OD*H)

PQ811E / PQ811EH

1800±20*580±30

物理化学性能 Physical & Chemical Properties

杂质含量

Trace Elements

单位 (Unit) : ppm

产品类型 Code	标准 Criteria	Al	Ca	Cr	Cu	Fe	K	Li	Mg	Mn	Na	Ti	Zr
PQ811E	典型值 Typical	13.0	0.50	<0.05	<0.05	0.10	0.10	0.30	0.05	0.05	0.10	1.30	1.00
	最大值 Maximum	19.0	1.00	0.10	0.10	0.50	1.00	1.00	0.20	0.20	1.00	2.00	2.00
PQ811EH	典型值 Typical	8.00	0.60	<0.05	<0.01	0.10	0.10	0.20	0.05	0.05	0.10	1.30	1.00
	最大值 Maximum	10.0	1.00	0.10	<0.01	0.50	0.50	0.50	0.20	0.20	0.50	2.00	2.00

羟基含量

OH Content

单位 (Unit) : ppm

PQ811E / PQ811EH

OH < 20

物理性能

Physical Properties

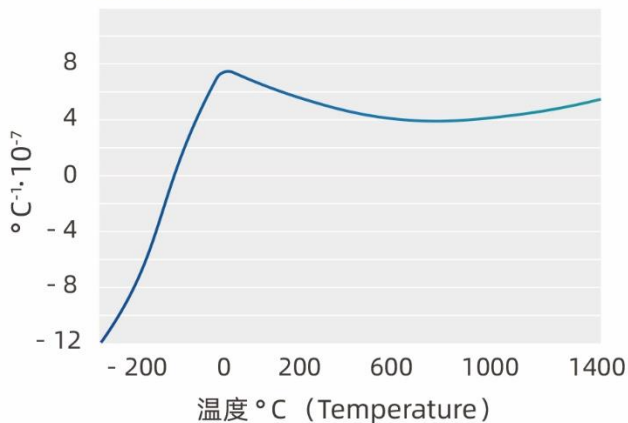
项目 Items	指标值 Values
体积密度 Density (g/cm ³)	2.2
导热系数 Heat Conductivity (w/m.k, 1000°C)	2.28
热膨胀系数 Coefficient Of Thermal Expansion (°C ⁻¹ , 1000°C)	5.5×10 ⁻⁷
软化点 Softening Point (°C)	1670
退火点 Annealing Point (°C)	1210
应变点 Strain Point (°C)	1110

热膨胀系数和粘度

Coefficient of Thermal Expansion & Viscosity

膨胀系数

Coefficient Of Thermal Expansion



粘度

Viscosity

